

## 江苏长电科技股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：长电国际（香港）贸易投资有限公司
- 投资金额：2 亿美元

### 一、对外投资概述

（一）本公司拟对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）增资 2 亿美元，并通过长电国际在韩国设立全资子公司 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED，投资高阶 SiP 产品封装测试项目。

（二）董事会审议情况：2015 年 11 月 17 日，公司第五届第三十四次董事会审议通过了《关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案》；2015 年 12 月 3 日，公司第六次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案》。

（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

（一）长电国际，本公司全资子公司，2015 年度资产总额为：7.2 亿元人民币，营业收入为：5.24 亿人民币，净利润：-231 万元人民币；2016 年 1-3 月营业收入为：1.25 亿元人民币。

（二）JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED 为长电国际在韩国设立的全资子公司，通过租赁星科金朋韩国公司（STATS ChipPAC Korea Limited，以下简称“韩国公司”）的厂房、部分设备，聘用原韩国公司 SIP 产品试样生产线相关人员，进行高阶 SiP 产品封装测试项目的生产运营。

### 三、对外投资对上市公司的影响

高阶 SiP(System in a Package, 即系统级封装)是代表集成电路封装测试行业发展趋势的先进技术,能满足高度集成化、功能性更强且规模更加紧凑的下一代设备的市场需求。

高阶 SiP 产品封装测试项目系按照公司“重点发展高端封装,加快发展特色封装,适度发展传统封装”产品战略,将先进封装技术产业化的重要步骤,项目实施后将为公司培育新的利润增长点。

### 四、对外投资的风险分析

投资标的最终投资项目实施地位于韩国,法律、政策、外汇等方面与国内存在一定差异,可能引致相应风险。由于星科金朋韩国公司有多年的韩国生产、研发等运营经验,为提高运营效率,本次投资将由长电国际在韩国设立全资子公司 JCET STATS CHIP PAC KOREA LIMITED 与星科金朋韩国公司配合实施,以降低相关风险。

本次增资已经江苏省商务厅备案。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十五日